

2018-2024年中国印制电路 板（PCB）市场前景研究与投资策略报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制

www.chinairr.org

一、报告报价

《2018-2024年中国印制电路板（PCB）市场前景研究与投资策略报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0602/201807/27-268695.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: sales@chyxx.com

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

PCB是英文Printed Circuit Board（印制线路板或印刷电路板）的简称。通常把在绝缘材料上按预定设计制成印制线路、印制组件或者两者组合而成的导电图形称为印制电路。

2008年以来，智能手机、平板电脑等消费类移动电子产品市场高速增长，极大地推动了FPC行业发展；同时，汽车自动化、联网化、电动化扩大了对车载FPC的需求。此外，近几年新兴的可穿戴智能设备、无人机等消费类电子产品市场也为FPC带来新的增长空间。下游电子产品的快速发展为FPC行业带来持续的需求动力。受此影响，自2008年以来，全球FPC产值保持持续稳定增长，截至2016年，全球FPC产值取得6.5%的复合增速，占PCB行业的比重稳定在20%以上。据预计，2021年FPC年产值预计将超过125亿美元，在PCB中占比有望提升到21%。

全球FPC产值保持稳定增长 数据来源：公开资料整理

2016年我国FPC产值规模达到354亿元，占全球比重达到50%。

我国FPC产值及占全球比重 数据来源：公开资料整理

中国产业研究报告网发布的《2018-2024年中国印制电路板（PCB）市场前景研究与投资策略报告》共十四章。首先介绍了印制电路板（PCB）市行业市场发展环境、印制电路板（PCB）市整体运行态势等，接着分析了印制电路板（PCB）市行业市场运行的现状，然后介绍了印制电路板（PCB）市市场竞争格局。随后，报告对印制电路板（PCB）市做了重点企业经营状况分析，最后分析了印制电路板（PCB）市行业发展趋势与投资预测。您若想对印制电路板（PCB）市产业有个系统的了解或者想投资印制电路板（PCB）市行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 印制电路板（PCB）的相关概述

1.1 PCB的介绍

1.1.1 PCB的定义

- 1.1.2 PCB的分类
- 1.1.3 PCB的历史
- 1.2 PCB的产业链
- 1.2.1 PCB产业链的构成
- 1.2.2 产业链中的产品介绍

第二章 2014-2017年国际PCB产业发展分析

- 2.1 2014-2017年全球PCB产业发展概况
 - 2.1.1 国际重点PCB制造企业的概述
 - 2.1.2 2016年全球PCB工业发展回顾
 - 2.1.3 2017年全球PCB行业发展状况
 - 2.1.4 2017年全球PCB产业发展动态综述
 - 2.1.5 国外印制电路板制造技术的发展
- 2.2 美国
 - 2.2.1 美国PCB产业的发展概况
 - 2.2.2 美国PCB主要生产厂家的发展
 - 2.2.3 北美PCB产业发展现状
- 2.3 欧洲
 - 2.3.1 欧洲PCB产业发展概况
 - 2.3.2 欧洲PCB行业发展开始恢复
 - 2.3.3 德国PCB产业的发展
- 2.4 日本
 - 2.4.1 日本PCB产业的发展阶段
 - 2.4.2 日本PCB产业的业发展回顾
 - 2.4.3 2014-2017年日本PCB产业的发展
 - 2.4.4 日本领先PCB厂商发展高端路线
- 2.5 台湾地区
 - 2.5.1 2016年台湾PCB产业的发展
 - 2.5.2 2014-2017年台湾PCB产业的发展
 - 2.5.3 台湾PCB企业在大陆市场的发展动态

第三章 2014-2017年中国PCB产业发展分析

3.1 2014-2017年我国PCB产业的发展概况

3.1.1 我国PCB产业的产值及产能

3.1.2 我国PCB产业的产品结构

3.1.3 我国PCB行业配套日渐完善

3.1.4 我国成全球最大PCB制造基地

3.1.5 我国PCB产业的发展机遇

3.2 PCB产业竞争力分析

3.2.1 竞争对手

3.2.2 替代品

3.2.3 潜在进入者

3.2.4 供应商的力量

3.3 HDI市场发展分析

3.3.1 HDI市场容量

3.3.2 HDI市场供求

3.3.3 HDI市场趋势

3.4 我国PCB产业发展问题及对策

3.4.1 我国PCB产业与国外存在的差距

3.4.2 PCB产业发展面临的挑战

3.4.3 PCB产业持续发展的措施

3.4.4 PCB产业需发展民族品牌

第四章 中国印制电路板制造业财务状况

4.1 中国印制电路板制造业经济规模

4.1.1 2011-2017年印制电路板制造业销售规模

4.1.2 2011-2017年印制电路板制造业利润规模

4.1.3 2011-2017年印制电路板制造业资产规模

4.2 中国印制电路板制造业盈利能力指标分析

4.2.1 2011-2017年印制电路板制造业亏损面

4.2.2 2011-2017年印制电路板制造业销售毛利率

4.2.3 2011-2017年印制电路板制造业成本费用利润率

4.2.4 2011-2017年印制电路板制造业销售利润率

4.3 中国印制电路板制造业营运能力指标分析

- 4.3.1 2011-2017年印制电路板制造业应收账款周转率
- 4.3.2 2011-2017年印制电路板制造业流动资产周转率
- 4.3.3 2011-2017年印制电路板制造业总资产周转率
- 4.4 中国印制电路板制造业偿债能力指标分析
 - 4.4.1 2011-2017年印制电路板制造业资产负债率
 - 4.4.2 2011-2017年印制电路板制造业利息保障倍数
- 4.5 中国印制电路板制造业财务状况综合分析
 - 4.5.1 印制电路板制造业财务状况综合评价
 - 4.5.2 影响印制电路板制造业财务状况的经济因素分析

第五章 2014-2017年PCB制造技术的研究

- 5.1 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述
 - 5.1.1 PCB芯片封装的介绍
 - 5.1.2 PCB芯片封装的主要焊接方法
 - 5.1.3 PCB芯片封装的流程
- 5.2 光电PCB技术
 - 5.2.1 光电PCB的概述
 - 5.2.2 光电PCB的光互连结构原理
 - 5.2.3 光学PCB的优点
 - 5.2.4 光电PCB的发展阶段
- 5.3 PCB技术的发展趋势
 - 5.3.1 向高密度互连技术方向发展
 - 5.3.2 组件埋嵌技术的发展
 - 5.3.3 材料开发的提升
 - 5.3.4 光电PCB的前景广阔
 - 5.3.5 先进设备的引入

第六章 2014-2017年PCB上游原材料市场分析

- 6.1 铜箔
 - 6.1.1 铜箔的相关概述
 - 6.1.2 铜箔在柔性印制电路中的应用
 - 6.1.3 电解铜箔产业的发展概况

6.2 环氧树脂

6.2.1 环氧树脂的相关概述

6.2.2 环氧树脂的主要应用领域

6.2.3 我国环氧树脂产业的发展现状

6.3 玻璃纤维

6.3.1 玻璃纤维的相关概述

6.3.2 我国成为全球最大玻璃纤维生产国

6.3.3 2014年我国玻璃纤维行业发展状况

6.3.4 2017年玻璃纤维产业运行分析

6.3.5 2017年玻璃纤维产业运行态势分析

第七章 2014-2017年PCB下游应用领域分析

7.1 消费类电子产品

7.1.1 2014年我国消费电子产品发展综述

7.1.2 2017年我国消费电子产品市场发展状况

7.1.3 2017年我国消费电子产品市场发展态势

7.1.4 消费电子用PCB市场需求稳定增长

7.1.5 高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热

7.2 通讯设备

7.2.1 2014年我国通讯设备制造业发展

7.2.2 2017年我国通信设备业的发展

7.2.3 2017年我国通信设备业的发展动态

7.2.4 语音通讯移动终端用PCB的发展趋势

7.3 汽车电子

7.3.1 PCB成为汽车电子市场的热点

7.3.2 多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大

7.3.3 全球汽车电子PCB市场发展预测

7.4 LED照明

7.4.1 中国LED照明的发展状况

7.4.2 LED发展为PCB行业带来新需求

第八章 国外重点PCB制造商介绍

- 8.1 日本企业
 - 8.1.1 日本揖斐电株式会社(IBIDEN)
 - 8.1.2 日本旗胜 (Nippon Mektron)
 - 8.1.3 日本CMK公司
- 8.2 美国企业
 - 8.2.1 MULTEK
 - 8.2.2 美国TTM
 - 8.2.3 新美亚 (SANMINA-SCI)
 - 8.2.4 惠亚集团 (Viasystems)
- 8.3 韩国企业
 - 8.3.1 三星电机 (Samsung E-M)
 - 8.3.2 永丰 (Young Poong Group)
 - 8.3.3 LG Electronics
- 8.4 台湾企业
 - 8.4.1 欣兴电子
 - 8.4.2 健鼎科技
 - 8.4.3 雅新电子

第九章 2014-2017年国内PCB上市公司经营状况

- 9.1 沪电股份
 - 9.1.1 企业发展概况
 - 9.1.2 企业核心竞争力
 - 9.1.3 经营效益分析
 - 9.1.4 业务经营分析
 - 9.1.5 财务状况分析
 - 9.1.6 未来前景展望
- 9.2 天津普林
 - 9.2.1 企业发展概况
 - 9.2.2 企业核心竞争力
 - 9.2.3 经营效益分析
 - 9.2.4 业务经营分析
 - 9.2.5 财务状况分析

9.2.6 未来前景展望

9.3 生益科技

9.3.1 企业发展概况

9.3.2 企业核心竞争力

9.3.3 经营效益分析

9.3.4 业务经营分析

9.3.5 财务状况分析

9.3.6 未来前景展望

9.4 超声电子

9.4.1 企业发展概况

9.4.2 企业核心竞争力

9.4.3 经营效益分析

9.4.4 业务经营分析

9.4.5 财务状况分析

9.4.6 未来前景展望

9.5 超华科技

9.5.1 企业发展概况

9.5.2 企业核心竞争力

9.5.3 经营效益分析

9.5.4 业务经营分析

9.5.5 财务状况分析

9.5.6 未来前景展望

9.6 上市公司财务比较分析

9.6.1 盈利能力分析

9.6.2 成长能力分析

9.6.3 营运能力分析

9.6.4 偿债能力分析

第十章 PCB行业投资分析及前景预测 (ZY GXH)

10.1 PCB投资分析

10.1.1 PCB行业SWOT分析

10.1.2 PCB投资面临的风险

- 10.1.3 PCB市场投资空间大
- 10.2 PCB产业发展前景预测
 - 10.2.1 国际PCB行业发展预测
 - 10.2.3 未来我国PCB行业将保持高速增长
 - 10.2.4 十三五期间我国PCB产业的发展重点
 - 10.2.5 2018-2024年我国印制电路板产业的发展前景预测（ZY GXH）

图表目录：

- 图表 各国家/地区PCB工厂数目
- 图表 全球不同种类PCB的增长率（按产品类型分）
- 图表 电子整机及PCB的应用领域和未来发展
- 图表 全球各国PCB产值
- 图表 电子工业（半导体）和PCB工业的增长
- 图表 全球各地区PCB产值分布
- 图表 全球主要手机PCB板厂家市场占有率
- 图表 全球PCB下游应用比例
- 图表 全球PCB产品结构
- 图表 美国PCB产值变化情况
- 图表 日本PCB产量统计表
- 图表 日本PCB厂家海外产值（按产品类型分类）
- 图表 日本PCB厂家海外产值（按国家分类）
- 图表 日本PCB进出口量（按国别统计）
- 图表 日本PCB出口量（按地区统计）
- 图表 日本印制电路板设备投资额
- 图表 台湾PCB的资本构成
- 图表 台湾不同种类PCB的比例
- 图表 台湾PCB市场规模
- 图表 中国PCB产业主要本土企业销售收入增长幅度
- 图表 2011-2017年印制电路板制造业销售收入
- 图表 2012-2017年印制电路板制造业销售收入增长趋势图
- 图表 2012-2017年印制电路板制造业不同所有制企业销售额
- 图表 2016年印制电路板制造业不同所有制企业销售额对比图

- 图表 2017年印制电路板制造业不同所有制企业销售额
- 图表 2017年印制电路板制造业不同所有制企业销售额对比图
- 图表 2011-2017年印制电路板制造业利润总额
- 图表 2012-2017年印制电路板制造业利润总额增长趋势图
- 图表 2012-2017年印制电路板制造业不同所有制企业利润总额
- 图表 2017年印制电路板制造业不同所有制企业利润总额
- 图表 2017年印制电路板制造业不同所有制企业利润总额对比图

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0602/201807/27-268695.html>